

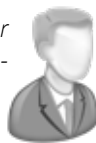
KOMPAKTSEMINAR. DRAHTBONDTECHNOLOGIE

Das Kompaktseminar ist der schnelle Einstieg in die Drahtbondtechnologie. Entwickler, Führungskräfte und Projektmanager finden hier komprimiert alles Wissenswerte zum Drahtbonds, um sich anschließend vertiefend weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln. In den 3 Seminartagen wird ausschließlich Theorie vermittelt. Praktische Demonstrationen und Übungen finden in den nach Themenschwerpunkten gegliederten Seminaren (Teil 1-4) statt.

Mit über 700 Teilnehmern und mehr als 20 Jahren Marktpräsenz ist das 3-Tages-Seminar zur Drahtbondtechnologie das erfolgreichste Schulungsformat der Bond-IQ zusammen mit dem Fraunhofer IZM und deutschlandweit von großen bis kleinen Unternehmen anerkannt und empfohlen. Es erwartet Sie umfangreiches Technologie Know-How – angefangen bei den Grundlagen bis zu wertvollem Netzwerk- und Insiderwissen. Mit diesem Portfolio an Informationen können Sie in allen Themenbereichen der Drahtbondtechnologie mitreden und wissen, wo relevante Informationen zu finden sind.

Egal, wo Sie zu Hause sind, ob in der Chip-on-Board Technik, Leistungsmodul-Technologie, Hochfrequenztechnik, Montage von Mikrosystemen oder Bereichen, in denen das Drahtbonds in Ihrem Unternehmen derzeit zur Schlüsseltechnologie reift – stellen Sie Ihre Fragen zur Diskussion. Sie werden begeistert sein. Das Seminar wird gemeinsam durch Bond-IQ und das Fraunhofer IZM Berlin gestaltet.

„Auch um das vorhandene Wissen zu vertiefen war das Seminar sehr hilfreich, zusätzlich gab es Ausblicke in die nicht bekannten Anwendungsfälle.“
(Michael Haas, Conti Temic microelectronic GmbH)



 3 Tage


 4-6 Teilnehmer

 2.970 €*
pro Teilnehmer

*Preisangaben pro Teilnehmer und zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer

Informationen / Anmeldung unter:

 www.bond-iq.de

 +49 30 46069009

 seminaranfrage@bond-iq.de

Ihr Lernerfolg

Wenn Sie das Seminar erfolgreich abgeschlossen haben, wissen Sie:

- welche Bondverfahren es am Markt gibt
- was die einzelnen Bondverfahren voneinander unterscheidet
- welche Materialien typischerweise zum Bonden eingesetzt werden
- welche Standards heranzuziehen sind und wo die entsprechenden Kennwerte in den Standards zu finden sind
- auf welche Materialkombinationen und -eigenschaften Sie achten müssen, wenn Sie Bauteile designen und für eine Anwendung auslegen

Zielgruppe

- Projektmanager
- Innovatoren
- Entwicklung
- Qualitätsverantwortliche
- SQM-Verantwortliche
- techn. & strateg. Leitungsebene
- Geschäftsführung

Ihre Vorteile

- Entscheidungssicherheit durch Ratschläge unabhängiger Experten
- effektivere Abstimmungsprozesse durch breites Wissen im Unternehmen
- schneller Wissenstransfer statt jahrelangem „learning by doing“
- nur relevantes anwenden – weniger Streuverluste bei Zeit und Kosten

KOMPAKTSEMINAR.

DRAHTBONDTECHNOLOGIE

	Tag 1	Tag 2	Tag 3
09:00	Begrüßung und Vorstellung	Schichtsysteme und Materialkombinationen in Bondanwendungen	Zuverlässigkeit Teil 1: Fehlermechanismen und Ursachen
09:30	Drahtbonden Technologieentwicklung Vergangenheit bis heute		Drahtstruktur, Gefügeveränderungen (Ver-/Entfestigung, Rekristallisation)
10:00	Drahtbondverfahren im Überblick	Prüfverfahren Visuelle Prüfung Pull-/Schertest zerst./nicht zerst. Tweezer-/Peeltest IMC-Test Needle-Test Inline-Pull-/Schertest Automatische	Interdiffusion, Kirkendallvoiding
10:30	Anwendungsfelder für die Drahtbondtechnologie		Korrosion
11:00	Marktüberblick (Materialien, Hersteller, internationale Situation, Netzwerke)	Mittagessen	Ermüdung
11:30			Kriechen
12:00	Mittagessen		Zuverlässigkeit Teil 2: Fehleranalysemethoden und Zuverlässigkeitstests
12:30			Mittagessen
13:00	Verbindungsbildung	Prüfstandards	Mittagessen
13:30	Prozessparameter	MIL-883, AEC-Q100/006, ASTM, JEDEC, IEC, IPC, DVS-2811	
14:00	Einflussfaktoren	Detaildiskussion zur Überarbeitung des DVS-2811	Zugeschnitten auf den Bedarf der Teilnehmer, ergänzende Informationen und Vorträge rund um die Themengebiete
14:30	Vertiefung der einzelnen Bondverfahren	Grundprinzip Vorgehensweise Parametereinstellung und -optimierung einfaktoriell und mittels Design-of-Experiment (DOE)	- COB-Technologie
15:00			- Packageanalyse
15:30		- erweiterte Bondstellenprüfung	
16:00		Bondprozessüberwachung	- Maschinenüberwachung
16:30			ergänzt mit Laborbeispielen aus dem Fraunhofer IZM Berlin
17:00			Empfehlung: Senden Sie uns Ihre Fragen vorab!
			Abschlussdiskussion

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Angebot der Bond-IQ und freuen uns auf die weitere zukünftige Zusammenarbeit.“
(Philipp Conrad, Würth Elektronik GmbH & Co. KG)



Ihre Referenten

- Stefan Schmitz
// Bond-IQ GmbH
// Drahtbond-Technologie & Trainer
// Geschäftsführer Bond-IQ
- Prof. Martin Schneider-Ramelow
// Fraunhofer IZM
// Wissenschaftler und Technologie
// Abteilungsleiter SIIT, Fraunhofer IZM

Equipment

- F&S Bondtec 5610, 5630, 5650, 5632
- F&S Bondtec 5810, 5830, 5850
- Pulltester 100 g bis 5 kg
- Schertester 500 g bis 50 kg
- Lichtmikroskop 100x bis 1000x
- Stereomikroskop bis 60x
- COB-Fertigungslinie
- Package- und Panel-Moldprozesse
- X-Ray(-CT) und Akusto-Mikroskopie
- Topographieanalytik

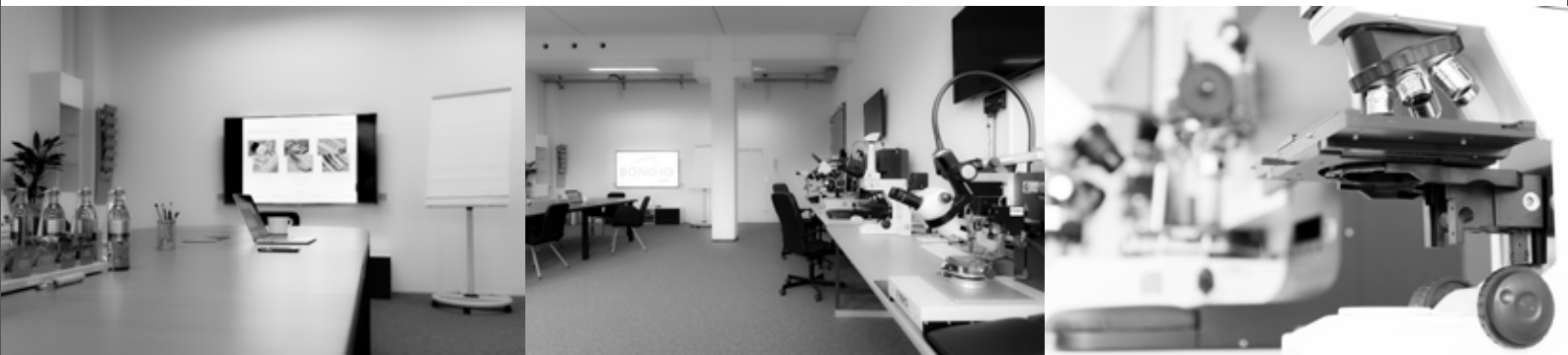
Hotelempfehlungen für Sie

- Hotel Grenzfall
Ackerstraße 136
13355 Berlin
Tel.: +49 30 34333300
www.hotel-grenzfall.de
- Mercure Hotel Berlin City
Invalidenstraße 38
10115 Berlin
Tel.: +49 30 308260
- Hotel Motel One Berlin Alexanderplatz
Dircksenstraße 36
10179 Berlin
Tel.: +49 30 20054080

Informationen / Anmeldung unter:

- www.bond-iq.de
- +49 30 46069009
- seminaranfrage@bond-iq.de


KOMPAKTSEMINAR. DRAHTBONDTECHNOLOGIE



ENHANCE WIRE BONDING

Informationen / Anmeldung unter:

 www.bond-iq.de

 +49 30 46069009

 seminaranfrage@bond-iq.de

 Fraunhofer
IZM

 BOND-IQ